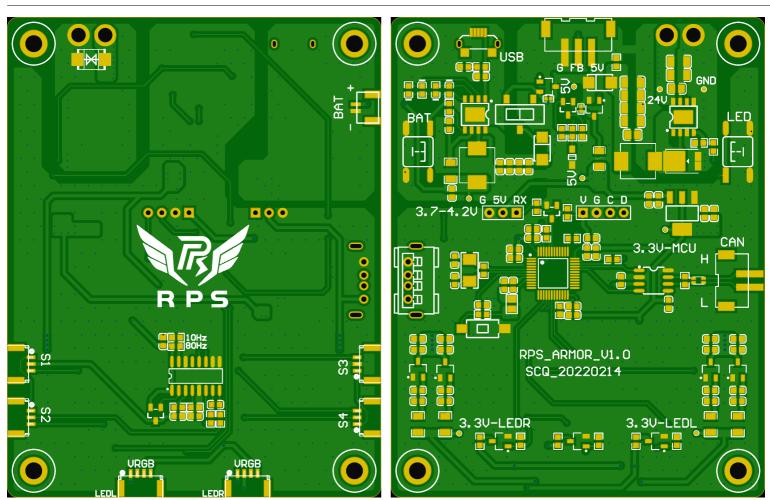


检查报告



时间2022-06-30

文件名: 层数: 2 尺寸: 70.00*90.00 mm



警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
电气信号	锐角	3个	锐角会导致信号走向突变,造成信号反射、传输不连续。 不推荐直角、锐角 尽量采用圆角、钝角 您的设计中布线存在"锐角"连接方式,会影响产品的信号完整性,建议将"锐角"位置调整为圆弧或钝角的连接方式
槽孔	槽长宽比	1.80417 mm	Slot槽的长小于两倍宽时属于短槽,此类槽孔在生产过程中,由于第二个孔受力不均易变形。 槽宽: 0.5mm———————————————————————————————————

焊盘规格	封装内间距异常	有异常	焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致,SMT加工时存在无法焊接的风险
焊盘规格	焊盘大小异常	有异常	焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致,SMT加工 时存在无法焊接的风险 +
孔环	过孔孔环	有	孔环大小会影响孔环的附着力及线与孔壁链接的完整性,适当加大焊环可增强产品的可靠性。 过孔孔环 → 插件孔焊环 → ← 插件孔焊环 → ←
板边距离	铜/PAD/线到板边距 离	板边异常	外形(板框)用于机械成型,焊盘、铺铜及走线都应避开外形线,避免出现锣断线或露铜的情况。 □
板边距离	SMD到板边距离	板边异常	SMD焊盘与板边距离过近,PCB成型时焊盘有损坏的风险,影响元件焊接的可靠性。 《外形边线》 您的 "SMD焊盘到板边" 最小间距为0.84mil,间距小于15.75mil,会影响焊盘的完整度,可能会导致焊锡不良,建议间距≥15.75mil

全部检查项

报告项目	类型	分析结果
	断头线	▼ 正常
	孤立铜	▼ 正常
电气信号	无效过孔	✓ 正常
	片式SMD没连线路	✓ 正常
	锐角	① 3pis 3个
最小线宽	最小线宽	✓ 正常 0.2032 mm

	线到线	✓ 正常
最小间距	盘到线	✓ 正常 0.184086 mm
	盘到盘	✓ 正常 0.184086 mm
最小焊盘	BGA焊盘	✓ 正常
	常规焊盘	☑正常
	长条焊盘	▼ 正常
	同网络SMD焊盘间距	
CMDiage	不同网络SMD焊盘间 距	✓ 正常 0.249936 mm
SMD间距	同器件焊盘间距	▼ 正常
	不同器件焊盘间距	▼ 正常
	网格线宽	▼正常
网格铺铜	网格线距	▼ 正常
	最小孔径	✓ 正常 0.3048 mm
孔大小	最大孔径	☑ 正常
	厚径比	▼ 正常
	最小槽宽	✓ 正常 1.80417 mm
 槽孔 	最大槽宽	▼ 正常
	槽长宽比	① 1pis 1.80417 mm
孔环	过孔孔环	① 599pis 有
	插件孔孔环	▼ 正常
孔到孔	同网络过孔	✓ 正常 0.3048 mm
	不同网络过孔	▼ 正常
	插件孔	▼ 正常

	过孔到表层	✓ 正常 0.3556 mm
孔到线	插件孔到表层	✓ 正常 0.3556 mm
	过孔到内层	✓ 正常
	插件孔到内层	▼ 正常
	NPTH到铜	☑ 正常
	铜/PAD/线到板边距 离	① 16pis 板边异常
板边距离	SMD到板边距离	① 16pis 板边异常
	孔到板边	▼ 正常
	半孔	▼ 正常
	盲埋孔	▼ 正常
特殊孔	盲埋孔距离	☑ 正常
	激光孔	☑ 正常
	正/长方形孔	☑ 正常
焊盘规格	焊盘大小异常	① 3pis 有异常
X+ 	封装内间距异常	① 5pis 有异常
	盘中孔	▼ 正常
71 上烟舟	插件孔	▼ 正常
孔上焊盘	过孔上焊盘	✓ 正常
	非金属孔	✓ 正常
阻焊开窗	阻焊异常	▼ 正常
	阻焊盖线	☑ 正常
	阻焊间隙	✓ 正常
	同网络阻焊间隙	▼ 正常
	漏阻焊桥	▼ 正常
	同网络漏阻焊桥	☑ 正常

孔密度	孔密度	① 387个;6.14万/m²
沉金面积	沉金面积	① 15.74%
飞针点数	飞针点数	① 462
Mark点	Mark点	✓ 正常
锣长分析	锣长分析	① 51.2604m/m²